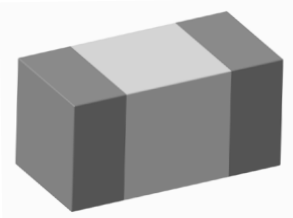


产品型号：MQB

1 产品特点

- ◆ 高的热导率、低热阻、低容值、可增加电路可靠性、提供更有效的散热方案。
- ◆ 产品采用 AlN 材料，具有优良导热能力，具有高可靠性。
- ◆ 产品通过将热导入散热平面、散热器或其他特定的散热点，进而有效控制元器件温度，提高了电路的可靠性。
- ◆ 固有电容值非常低，因此产品可在射频、微波频段应用。
- ◆ 产品可以对所连接的器件提供额外保护，避免热点高温的影响，是非常经济的热管理解决方案。
- ◆ 产品尺寸符合 EIA 标准，尺寸可定制。
- ◆ 包装采用编带包装或客户指定方式。



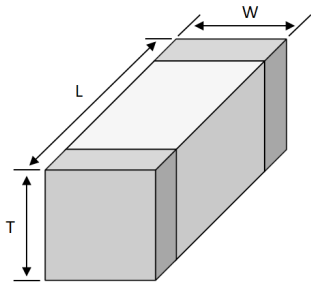
2 产品应用

GaN 功率放大器、高射频功率放大器、滤波器、合成器、工业计算机、开关电源、PIN 和激光二极管。
应用位置：有源器件和邻近地平面间、特殊的连接点到外壳、热点到散热面、元器件直接连接到过孔焊盘、金属化器件的边缘。

3 订货示例

MQB	0603	B	W	N	C
产品型号	外形尺寸代码	厚度代码	引出端形式	引出端材料	包装形式
MQB	EIA 标准	A:0.52±0.10 B:0.65±0.10 C:1.05±0.10 D:1.55±0.10	端头包裹	N：银－镍－锡 TN：银－铜－锡	C：编带 B：散装

热桥结构和外形尺寸



单位：mm

外形尺寸代码	长 (L)	宽 (W)	厚度 (T)	厚度代码
0302	0.81±0.20	0.65±0.20	0.52±0.10	A
0402	1.06±0.20	0.65±0.20	0.52±0.10	A
0505	1.31±0.20	1.41±0.20	0.65±0.10	B
0603	1.56±0.20	0.90±0.20	0.65±0.10	B
0805	2.07±0.25	1.41±0.25	1.05±0.10	C
1005	2.58±0.25	1.41±0.25	1.05±0.10	C
1020	2.58±0.25	5.22±0.50	1.05±0.10	C
1111	2.83±0.24	2.93±0.25	1.05±0.10	C
2010	4.99±0.50	2.55±0.25	1.55±0.10	D
2525	6.14±0.50	6.49±0.50	1.55±0.10	D
3725	9.44±0.50	6.37±0.50	1.55±0.10	D
3737	9.31±0.50	9.67±0.50	1.55±0.10	D

MQB 热桥

4 产品热阻

外形尺寸代码	热阻 (°C /W)	外形尺寸代码	热阻 (°C /W)
0302	18	1020	3
0402	23	1111	6
0505	10	2010	8
0603	19	2525	4
0805	10	3725	6
1005	12	3737	4

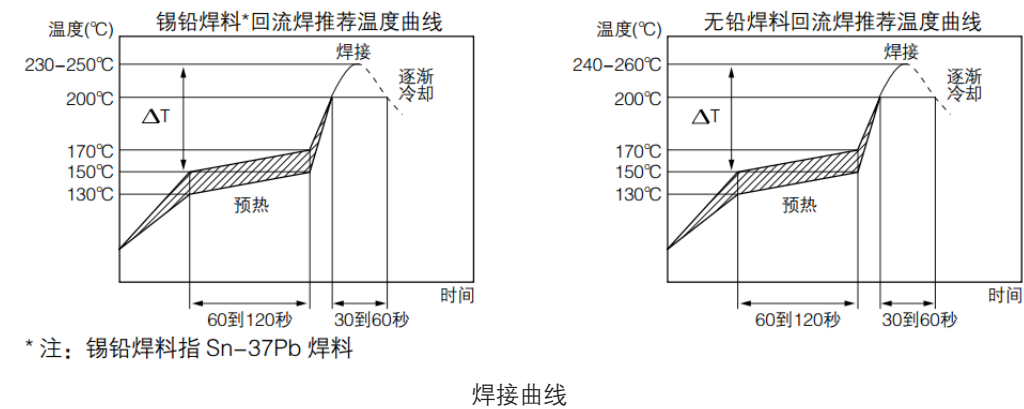
5 安装方式

- 1) 应采用正确的安装方式安装产品；
- 2) 严格禁止将产品二次拆装焊接。

6 推荐焊接

选用的最佳焊接方式是回流焊，推荐的焊接曲线见图 1。根据实际条件，请试验出匹配的焊接工艺，图 1 曲线仅供参考，不作为产品考核指标。

当产品采用手工焊接时，为保证产品可焊性，必须使用助焊剂。



7 储存

产品应储存在环境温度为 -10℃ ~ 40℃，相对湿度不大于 80%，周围无酸性、碱性及有害气体的库房中。

产品打开包装后，若需继续储存需真空包装或在氮气保护中储存。

产品储存期应不超过 18 个月。